

## 江苏芯丰集成电路封装压焊图

图号:314BD013

版本 A.0

贴片方向(芯片与片环方向示意图)



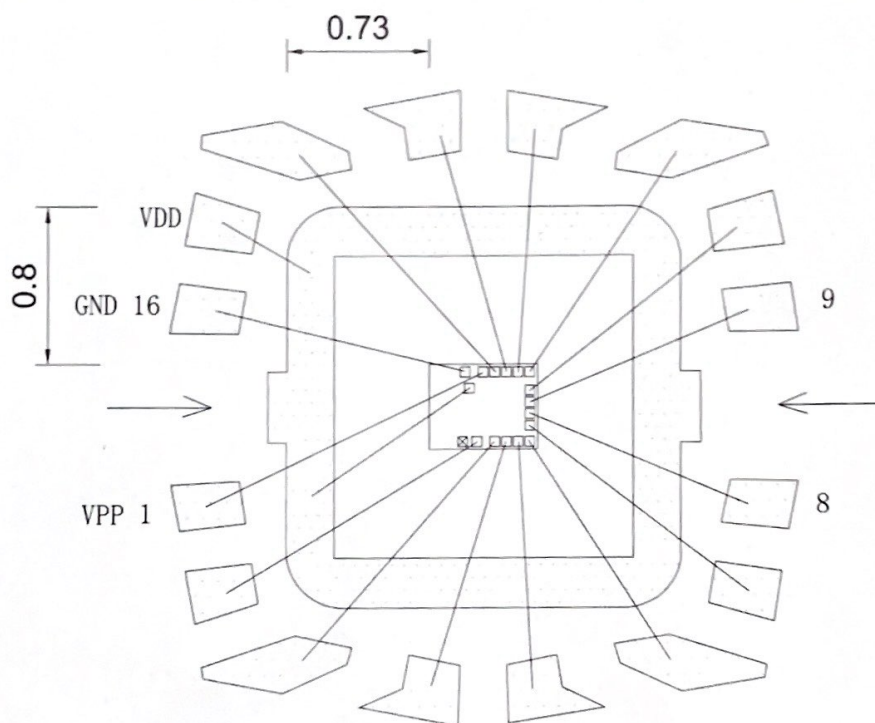
框架传输进料方向

第一个孔为椭圆孔



备注及特殊要求 (Remark&amp;Special Instruction)

框架到芯片最高点的线弧高度&lt;550um

请仔细核对焊线位置, 以及材料选择。如无误  
请签字回传, 谢谢!

客户回签: 模场涛 2024.4.19

顶针		点胶方式		如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线, 如不能请讲明	<input type="checkbox"/> UV膜 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝膜	风险监控: 低风险		
单顶针	多顶针	点胶	画胶					
	/	•	/					
产品型号 (Product Type)		HS8000P		线材直径 (Wire Diameter)		银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 Chip thinning thickness	300±10um
芯片名称 (Die Name)		HS5122		压焊点尺寸 (Pad Opening)		50.35X50.35um	装片胶 Epoxy	首选 NC9112(绝缘胶)
芯片尺寸 (Die Size)		0.5548X0.4332mm		最小压焊间距 (Min Pitch)		60um	(二选一)	备选 /
封装形式 (Package Type)		SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start)		PIN16	塑封料 Molding Compound	首选 EMC-GR710F GN
引线框 (Lead Frame)		SOP16L(12R)(80×80) -H		焊线总数 (Quantity of Wire)		17	(二选一)	备选 EMG-600-2-SP1
L/F电镀方式 (L/F Plating Type)		雾锡		最长线长/总线长 (Length of Wire)		1.49/21.691mm	CUP/BOAC	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)		8寸/刀片开槽+刀片切割		顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)		1.0um(3层)	RF 芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
吸嘴 (suction nozzle)		RT-010		切割道(Cutting Way)		60um	LOW-K芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
拟制 Prepared by		顾馨 2024.04.18		审核 Checked by			批准 Approved by	